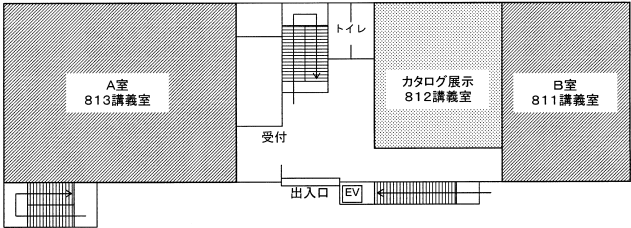


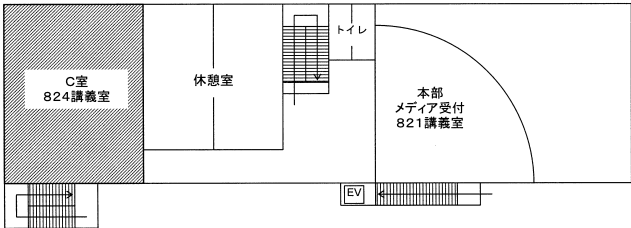
MES 2007 プログラム		9月13日(木)	
	A 室	B 室	C 室
10:30	【1A1】ナノテク・MEMS I 座長：菅沼克昭（大阪大学） 1. 銅ナノ粒子複合熱可塑性ポリアミミック酸微粒子の作製および接合材料としての応用 森 雅啓，赤松謙祐，縄舟秀美（甲南大学） 2. 原子状水素洗浄によるインクジェット銅配線形成 宮崎靖雄，和泉 亮，石原政道（九州工業大学） 3. ITO ナノ粒子ペーストによる透明導電性薄膜の電気的特性に及ぼす焼成条件の影響 竹村康孝（奥野製業工業），古田晋也（巴製作所），柏木行康，山本真理，中許昌美（大阪市立工業研究所） 4. 室温乾燥で50 $\mu\Omega\text{cm}$ の体積抵抗値を示すナノ粒子導電インクの開発 武居正史，外村卓也，山田 充（バンドー化学），桑本滋生（ひょうご科学技術協会），畑 克彦（バンドー化学）	【1B1】接合技術 座長：伊達仁昭（富士通研究所） 1. 狭ピッチに対応した高信頼性 COG (Chip On Glass) 接続技術 田中秀一，今井英生，伊東春樹，水野伸二，橋元伸晃，間々部明（セイコーエプソン） 2. 銀-エポキシ導電性接着剤の耐衝撃強度評価 金 道燮，姜 玟，金 植鉢，金 善植，金 聲俊，菅沼克昭（大阪大学），于 強（横浜国立大学） 3. 自己組織化実装法による導電路形成過程の数値解析 大田皓之，戸屋正雄，元重慎市，安田清和，松嶋道也，藤本公三（大阪大学） 4. 液体 Ga によるはんだ接合部の常温分離 園田悠太（物質・材料研究機構，芝浦工業大学），細田奈麻絵（物質・材料研究機構），今井八郎（芝浦工業大学），須賀唯知（東京大学）	【1C1】鉛フリーはんだ材料 座長：安田清和（大阪大学） 1. Zn-Sn 系高温鉛フリーはんだを用いたダイアタッチ 金 声俊，金 植鉢，金 道燮，菅沼克昭（大阪大学） 2. 2 元共晶複合手法を用いた高温鉛フリーはんだ材料 古澤彰男（松下電器産業），田中正人（松下ソリューションテクノロジー），末次憲一郎（松下電器産業） 3. Bi-In-Sn 合金の低温はんだ適用に関する基礎的検討 赤田裕亮，近藤末希，廣瀬明夫，小林絃二郎（大阪大学） 4. Sn-Ag-Cu-In 系微小接合体の低サイクル疲労寿命評価 神田喜彦，荻谷義治（芝浦工業大学），小原裕一（古河電気工業）
11:50	12:50 【1A2】ナノテク・MEMS II 座長：福岡義孝（ウェイスティール） 1. 常温焼結ナノ粒子ペーストの性質および焼結メカニズム 和久田大介，菅沼克昭（大阪大学） 2. Water-Laser 複合加工システムの精密加工 山田 正，佐々木 基，小関良治（澁谷工業） 3. メンブレン式感圧センサ 大森喜和子，小野朗伸，川平哲也（フジクラ），阿保 渉（青森フジクラ金矢），高野敦俊（藤倉化成） 4. 低電圧駆動・広チューニングレンジ・高線形性の RF-MEMS 可変キャパシタ 西元琢真，山下喜市，大畠賢一（鹿児島大学） 14:10 【1B2】高速伝送 座長：小池真司（日本電信電話） 1. VGPAS における 45° ミラー部分の光結合特性に関する検討 若園芳嗣，鈴木 敦，長尾太介，石川隆朗，樋野智之，橋本陽一，増田 宏，鈴木修司，田村充章，鈴木貞一，菊地克弥，仲川 博，青柳昌宏，三川 孝（産業技術総合研究所） 2. 光モジュールパッケージにおける 10 Gbps 電気信号伝送の検討 鈴木 敦，若園芳嗣，長尾太介，石川隆朗，樋野智之，橋本陽一，増田 宏，鈴木修司，田村充章，鈴木貞一，菊地克弥，仲川 博，青柳昌宏，三川 孝（産業技術総合研究所） 3. 伝送線路設計を用いた 10 GHz-BGA パッケージの開発 原 秀和，千野 満（ミスズ工業），菊地克弥，仲川 博，青柳昌宏（産業技術総合研究所） 4. 基板誘電体構造が差動伝送特性に及ぼす影響の解析 池谷昭雄，高田芳文（日立製作所），田中 仁（メイテック） 14:20 【1C2】鉛フリーはんだ実装 座長：末次憲一郎（松下電器産業） 1. SnInAgBi はんだ実装の接続強度に関する一考察 山田 保，齋藤啓一，福山正雄，荒木伸行，中川 彬（パナソニックモバイルコミュニケーションズ） 2. 鉛フリーはんだを用いた BGA パッケージの耐衝撃性評価 西村哲郎，末永将一，宮岡志典，関 園子（日本スぺリア社） 3. 鉛フリーはんだ溶湯中における炭素鋼の溶食挙動 山内 啓，関戸義仁，黒川一哉，田中順一（北海道大学） 4. アンモニア活性種による鉛フリーはんだ原料の酸化物除去 加賀田 暁，和泉 亮（九州工業大学）		
14:10	14:20 【受付】813 講義室前 A 室：813 講義室前（1 階） B 室：811 講義室前（1 階） C 室：824 講義室前（2 階） カタログ展示：812 講義室（1 階）		
14:20	14:35 【休憩】 会 場：甲南大学 5 号館（カフェ・パンセ） 参加費：4,000 円（消費税込み）＊MES 参加費には含まれておりません。		
14:40	14:40 招待講演 座長：縄舟秀美（MES2007 組織委員長 甲南大学） 1. SiP 基板標準化のための SIPOS 活動 友景 肇（福岡大学） 2. 次世代エレクトロニクス実装とめっき技術 若林信一（新光電気工業）		
16:40	16:40 【受付】813 講義室前 A 室：813 講義室前（1 階） B 室：811 講義室前（1 階） C 室：824 講義室前（2 階） カタログ展示：812 講義室（1 階）		

17:00	17:00 交流会 会 場：甲南大学 5 号館（カフェ・パンセ） 参加費：4,000 円（消費税込み）＊MES 参加費には含まれておりません。
19:00	

1階イメージ



2階イメージ



MES 2007 プログラム			9月14日（金）
	A 室	B 室	C 室
9:45	【2A1】次世代高密度実装技術の課題と検討 座長：西田秀行（ニシダエレクトロニクス実装技術支援） 1. LCD ドライバ搭載用銅めっきバンプ付き COF テープ基板とパッケージング 宮本宣明, 珍田 聡, 菅野 優（日立電線） 2. IC 内蔵薄型ポリイミド多層配線板 岡本誠裕, 奥出 聡, 鈴木孝直, 中尾 知（フジクラ） 3. 局所熱変形計測を用いたバンプはく離検出分解能向上の検討 佐藤祐規, 三浦英生（東北大学） 4. 高出力 LED モジュールの低熱抵抗化 須藤公彦, 小山 洋, 中里典生（日立製作所）	【2B1】評価 座長：竹本 正（大阪大学） 1. 導電性接着剤の疲労損傷評価 梶引了輔, 石野宏明, 菊谷義治（芝浦工業大学） 2. 導電性接着剤の実装信頼性試験方法の検討 平田拓哉, 小林晶子, 田中浩和（エスベック） 3. イオンマイグレーション機構の解析に対する交流インピーダンス法の適用 千葉大祐, 吉原佐知雄（宇都宮大学）, 横山直樹（東都化成） 4. 論理 IC 実装時に発生する抵抗を伴うリード浮きに対する電流テスト能力評価 小野安季良（詫間電波工業高等専門学校）, 一宮正博, 四柳浩之, 橋爪正樹（徳島大学）, 月本 功, 高木正夫（詫間電波工業高等専門学校）	【2C1】めっき技術 ―回路形成― 座長：松岡政夫（立命館大学） 1. マイクロコンタクトプリンティング法を利用した銅ダマシンプロセス 赤松謙祐, 尾山祐斗, 中嶋勝之, 縄舟秀美（甲南大学） 2. カップリング剤を用いた無電解銅めっきによる微細配線技術 中川香苗, 谷 元昭, 水越正孝（富士通研究所） 3. ポリイミド樹脂の化学的表面改質を利用した透明導電薄膜の作製 杉山正剛, 赤松謙祐, 縄舟秀美（甲南大学） 4. Direct Metallization 法を利用したガラス基板上への回路形成 松村康史（新日鐵化学, 甲南大学）, 榎本 靖（新日鐵化学）, 赤松謙祐, 縄舟秀美（甲南大学）
11:05	休憩		
11:15	【2A2】システム・イン・パッケージの信頼性向上 座長：田畑晴夫（ローム） 1. 高い二次実装信頼性を有するウエハレベルパッケージの開発 橋元伸晃, 田中秀一, 大栢俊平, 伊東春樹（セイコーエプソン） 2. マイクロスケールストレーンセンサを用いたフリップチップ実装構造内部ひずみの測定に関する研究 佐々木拓也, 上田啓貴, 三浦英生（東北大学） 3. 三次元フリップチップ実装構造における低応力構造設計指針の提案 上田啓貴, 佐藤祐規, 三浦英生（東北大学） 4. はんだバンプによるファインピッチ・フリップチップ実装技術開発 鳥山和重, 折井靖光（日本アイ・ビー・エム）	【2B2】シミュレーション I 座長：齊藤雅之（NEDO） 1. はんだリフロー時における電子パッケージ内部でのはく離発生予測評価 池田 徹, 濱田 学, 宮崎剛幸（京都大学）, 田中宏之, 沼田 孝（住友ベークライト） 2. 修正コフィニ・マンソン則による Sn-Ag-Cu はんだ疲労寿命の予測検討 山本 剛（富士通）, 作山誠樹, 清水浩三（富士通研究所） 3. はんだ接合部のばらつきが及ぼす熱疲労寿命への影響 高木寛二（横浜国立大学, オムロン）, 于 強, 澁谷忠弘, 宮内裕樹, 白鳥正樹（横浜国立大学）, 野呂幸弘（オムロン） 4. 携帯電話筐体の落下姿勢の変化による負荷とばらつきを検証 藤田雅人, 于 強（横浜国立大学）, 片平孝祥（ノキア・ジャパン）, 柴田豪紀, 佐次敬太, 白鳥正樹（横浜国立大学）	【2C2】めっき技術 ―微細配線― 座長：大塚邦顕（奥野製薬工業） 1. 高精細配線対応無電解 Ni-P/Pd/Au めっき技術 江尻芳則, 櫻井健久, 畠山修一, 有家茂晴（日立化成工業）, 川上 裕, 長谷川 清（日立化成エレクトロニクス） 2. 無電解銅めっきによる微細ホールのボトムアップ堆積 原田優作, 美吉要文, 奥村典昭, 新宮原正三（関西大学） 3. 無電解めっきを用いた FPC と ITO の新しい接続方法 和久田陽平, 渡辺充広, 小岩一郎（関東学院大学）, 大倉啓幸, 川手恒一郎, 安井秀明（住友スリーエム）, 本間英夫（関東学院大学） 4. 銀ナノ粒子触媒の触媒活性評価 高橋久弥（日本電気）, 小林靖之（大阪市立工業研究所）, 古宇田 光（日本電気）, 藤原 裕（大阪市立工業研究所）
12:35	昼休み		
13:30	【2A3】回路基板 I ―多層配線板― 座長：馬場和宏（日本電気） 1. レジストフィルムを用いたスルーホール形成方法 種 阜也, 太田直登, 赤木陽介, 弓指保晃, 内木場文男（日本大学） 2. ダイレクトレーザ加工法における銅表面処理とバリ取りエッチング 中村幸子, 池尻篤泰, 前田幸弘（メック） 3. キャビティ構造を有した高密度全層 IVH プリント配線板の開発 北 貴之, 東谷秀樹, 中村植志（パナソニックエレクトロニクデバイス）, 加賀美金雄（パナソニックエレクトロニクデバイス山梨） 4. ペアチップと受動チップ部品を内蔵する配線板の開発 笹岡賢司, 本村知久, 森岡直樹（大日本印刷）, 福岡義孝（ウェイスティー）	【2B3】シミュレーション II 座長：池田 徹（京都大学） 1. エレクトロニクス実装プロセスにおける樹脂流動解析 齋藤圭一, 林垣 新, 小島裕哉（プラメディア）, 橋本知久（京都工芸繊維大学） 2. 板理論を用いたプリント基板の反り計算手法の確立 永田孝弘, 三上貴央, 藤川正毅（メカニカルデザイン） 3. パッケージの粘弾性反り計算ツール 平田一郎（日本電気） 4. POP 構造半導体パッケージ反り予測の高精度化 伊東伸孝, 夏秋昌典, 青木広志, 高島 晃（富士通）, 水谷大輔, 倉科 守（富士通研究所）	【2C3】実装信頼性 座長：藤原 裕（大阪市立工業研究所） 1. Sn ウィスカ抑制用表面処理 Sn めっきの諸特性 (II) 金 種鉄, 金 善植, 金 声俊, 菅沼克昭（大阪大学）, 辻本雅宣, 梁田 勇（上村工業） 2. 自然発生型錫ウィスカ発生における金属間化合物ネットワークの影響 山下拓馬, 澁谷忠弘, 于 強, 白鳥正樹（横浜国立大学） 3. 講演中止 4. はんだバンプのリフロー接続性に及ぼす転写ペーストの金属粒子特性評価 宗像宏典, 前田 憲, 境 忠彦, 酒見省二（パナソニック ファクトリーソリューションズ）
14:50	休憩		
15:00	【2A4】回路基板 II ―マイクロ加工― 座長：榎本 亮（イビデン） 1. 表面処理メタルマスクによるマイクロソルダーリング技術 近藤 正, 佐藤恵美, 井原仁史, 武田龍一（ユケン工業） 2. 金/銅パット間への無電解三元合金中間層の挿入がワイヤーボンディング特性に与える影響 本間景虎, 小岩一郎, 和久田陽平, 本間英夫（関東学院大学） 3. 回路形成を目的としたポリイミドフィルムへの無電解 Cu-Ni 合金めっき 村上朋史, 森口 朋, 青木弘行, 松浪卓史（奥野製薬工業）, 濱澤晃久（荒川化学工業） 4. ポリイミド樹脂の部位選択的エッチングを利用した微細銅ダマシンプロセス 青木智美, 赤松謙祐, 縄舟秀美（甲南大学）, 柳本 博, 別所 毅（トヨタ自動車） 5. ダイレクトメタライゼーション法における再イミド化に関する検討（第2報） 森田芳郎, 村山里奈, 小川将志, 今瀧智雄（シャープ） 縄舟秀美（甲南大学）	【2B4】シミュレーション III 座長：江間富世（パナソニックモバイルコミュニケーションズ） 1. 直接メタノール型燃料電池の効率に及ぼす電極および流路構造の影響 杉村昌彦, 安田清和, 松嶋道也, 藤本公三（大阪大学） 2. チップ抵抗の鉛フリーはんだ疲労寿命へのシミュレーション応用例 荒深貴幸, 朴 燦鐘, 左右田 修（矢崎部品）, 佐藤勝美（矢崎総業）, 于 強（横浜国立大学） 3. チップ部品の鉛フリーはんだ接合部疲労信頼性に対するボイドの許容基準評価 于 強, 澁谷忠弘, 田中彬史, 小林祐介, 白鳥正樹（横浜国立大学）	【2C4】実装材料 座長：天明浩之（日立製作所） 1. 高耐熱, 低誘電正接材料の開発 藤澤洋之, 田宮裕記, 中村善彦（松下電工） 2. 高誘電率感光性ポリイミドの開発 原 義豪, 朝日 昇, 水口 創, 野中敏央（東レ） 3. 長期高精度塗布 SMD 接着材料の開発 桑原 涼, 岸 新, 山口敦史, 宮川秀規（松下電器産業） 4. 熱硬化性フィルム接着剤の硬化挙動解析 川手恒一郎（住友スリーエム）
16:40			

* 題名, 発表者などプログラムの内容は変更されることがあります。予めご了承ください。